+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Машина для лазерного разделения групповых заготовок и резки печатных плат HGTECH

Машина для лазерного разделения групповых заготовок и резки печатных плат HGTEC

Image not found or type unknown

Цена:

Цена по запросу

Описание

Станки для лазерной резки используют высокопроизводительный холодный лазерный источник, идеально обеспечивая резку групповых заготовок, контурную резку, выжигание отверстий и работу с защитными покрытиями.

Сверхтонкая обработка. Оборудование используется для прецизионной резки гибких печатных плат, жестких печатных плат, жесткогибких печатных плат.

Машина оснащена высокопроизводительным УФ-лазерным источником холодного света, высокоточной технологией позиционирования изображения CCD и самостоятельно разработанным программным обеспечением для визуального управления лазером.

Гибкий станок для лазерной резки печатных плат от HGLASER идеально выполняет контурную резку, сверление и маркировку печатных плат, а также точную обработку композитных мембран.

Ключевые характеристики

- Одноступенчатое формование, экономичная и эффективная работа.
- Прецизионный двумерный рабочий стол и полностью замкнутая система ЧПУ обеспечивают высокую точность позиционирования и разделения в микронах.
- Датчик положения и технология позиционирования изображения CCD.

Лазер	Лазерный источник	355 nm UV
	Мощность	10 W
	Коаксиальное видео-позиционирование	B/W CCD

Диапазон сканирования	60×60 mm	
Диаметр Сфокусированного Пятна	<20 um (UV Лазер)	
Система автофокусировки	автофокусировка по оси Z	
Точность Управления Фокусом	0.01 mm	
Конфигурация	X-Y Рабочая платформа	Ac серво-привод
	База	Высокоточная гранитная платформа
	Диапазон перемещения	300×400 (Опционально выше*)
	Разрешение Движения Платформы	0.5 um
	Общая Система Управления	IPC
	Вспомогательная Система Управления	Mitsubishi PLC
	Источник освещения CCD	620 nm красный LED свет
	Внешнее Вспомогательное Устройство	Воздуходувка (забор воздуха) с отрицательным давлением, система пылеулавливания
Характеристики обработки	Диапазон Размеров Обработки	360 × 460 mm
	Минимальная Линейная Ширина	20 um
	Точность Сшивания	±5 um

Точность Коррекции Сканирующей Головы	±5 um	
X-Y Точность коррекции стола	±4 um	
CCD Точность совмещения	7 µm	
Точность обработки	±4 микрометра	
Толщина обработки	<1 mm	
Питание	AC 220V ± 10%, 50HZ, 1 фаза, 3 КВт	
Условия работы	Расположение и подключение	Настройка в соответствии с потребностями
	Рабочие форматы	DXF, GBR, etc.
	Рабочая температура	15-30° (для более высокой точности требуется постоянная температура)
	Влажность	<50%
	Вес	1500 кг
	Габариты	1350 mm × 1050 mm × 1950 mm